

Title (en)
Glue preparation device

Title (de)
Leimaufbereitungsvorrichtung

Title (fr)
Dispositif de préparation de colle

Publication
EP 2269910 A2 20110105 (DE)

Application
EP 10165258 A 20100608

Priority
DE 102009033030 A 20090702

Abstract (en)
The device (1) has a receiving area (2) for receiving glue. A temperature control unit (4) heats the glue in the receiving area. Transport lines (6a, 6b) are provided to transport the glue from the receiving area to a processing area (8). Another temperature control unit (10a) and a third temperature control unit (10b) are arranged in respective areas of the transport lines to heat the glue guided in the transport lines. The receiving area is in the form of a container whose inner surface facing interior is partially made of iron. The container is sectionally designed in multiple layers. An independent claim is also included for a method for heating label glue.

Abstract (de)
Die Erfindung bezieht sich auf eine Leimaufheizvorrichtung (1), insbesondere zum Aufheizen von Etikettenleim, umfassend einen Aufnahmebereich (2) zur Aufnahme von Leim, ein erstes Temperierungsmittel (4) zum Erwärmen des Leims in dem Aufnahmebereich (2) eine Transportleitung (6a, 6b) zum Transport des Leims von dem ersten Aufnahmebereich (2) zu einem Verarbeitungsbereich (8). Erfindungsgemäß ist im Bereich der Transportleitung (6a, 6b) ein zweites Temperierungsmittel (10a, 10b) zum Erwärmen des in der Transportleitung (6a, 6b) geführten Leims vorgesehen.

IPC 8 full level
B65C 9/22 (2006.01); **B05C 1/08** (2006.01); **B05C 9/14** (2006.01); **B05C 11/10** (2006.01)

CPC (source: EP)
B05C 1/0813 (2013.01); **B05C 9/14** (2013.01); **B05C 11/1042** (2013.01); **B65C 9/22** (2013.01)

Cited by
CN111032518A; US11534792B2; WO2019037970A1

Designated contracting state (EPC)
AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO SE SI SK SM TR

Designated extension state (EPC)
BA ME RS

DOCDB simple family (publication)
EP 2269910 A2 20110105; **EP 2269910 A3 20130109**; **EP 2269910 B1 20151125**; CN 101941542 A 20110112; DE 102009033030 A1 20110105

DOCDB simple family (application)
EP 10165258 A 20100608; CN 201010219808 A 20100623; DE 102009033030 A 20090702